PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 09230595 A

(43) Date of publication of application: 05.09.97

(51) Int. CI

G03F 7/033

G03F 7/004

G03F 7/039

H01L 21/027

(21) Application number: 08063775

(22) Date of filing: 26.02.96

(71) Applicant:

NIPPON ZEON CO LTD

(72) Inventor:

TAKAHASHI SHINICHI

SONE ATSUSHI

(54) RESIST COMPOSITION AND ITS UTILIZATION

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a resist compsn. retaining high transparency by making polycylic polyolefin resin carry an acid-unstable structure.

SOLUTION: This resist compsn. contains at least one kind of resin repeatedly carrying at least one kind of acid-unstable structure on polycyclic polyolefin resin as a base resin and a photosensitive acid generating

material as essential components. The acid-unstable structure has a group represented by an acid-unstable group, an acid-labile group, an acid-decomposable group, etc., known in the field of a chemical amplification type resist and the group is decomposed by an acid and increases the alkali solubility of the base resin. The polycyclic polyolefin resin is a known resin such as a polymer obtd. by ring opening polymn. of a monomer having a norbonane skeleton.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-230595

(43)公開日. 平成9年(1997)9月5日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FI			技術表示箇所
G03F	7/033			G03F	7/033		
	7/004	503			7/004	503	
	7/039	501			7/039	501	
H01L	21/027	,	H01L	21/30	502	₹	
				審査請求	大簡末 第	請求項の数4	FD (全 8 頁)
(21)出願番号		特顯平8-63775	(71) 出頭人	000229	000229117		
					日本ゼ	オン株式会社	
(22) 出願日		平成8年(1996)2月26日			東京都	千代田区丸の内は	2丁目6番1号
			(72)発明者	商桶	信一		
					神奈川	県川崎市川崎区を	支光1-2-1 日
					本セオ	ン株式会社内	•
				(72)発明者	曾根 :	煁	
					神奈川	県川崎市川崎区で	友光1-2-1 日
					本ゼオ	ン株式会社内	•
			•				

(54) 【発明の名称】 レジスト組成物およびその利用

(57) 【要約】

【課題】 ArFエキシマレーザーなどの遠紫外線、X 先、電子線などの荷電粒子線といった放射線を用いる半 **導体素子の超微細加工に有用なレジストとして好適なレ** ジスト組成物を提供する。

【解決手段】 酸不安定性構造が基体樹脂に担持されて いる少なくとも1種類の樹脂(A)と、光感応性酸発生 物質(B)とを必須成分とするレジスト組成物であっ て、樹脂(A)の基体樹脂が多環式ポリオレフィン樹脂 であることを特徴とするレジスト組成物。

.

【特許請求の範囲】

酸不安定性構造が基体樹脂に担持されて 【請求項1】 いる少なくとも1種類の樹脂(A)と、光感応性酸発生 物質(B)とを必須成分とするレジスト組成物であっ て、樹脂(A)の基体樹脂が多環式ポリオレフィン樹脂 であることを特徴とするレジスト組成物。

1

【請求項2】 多環式ポリオレフィン樹脂がノルボルネ ン骨格を有するモノマーの開環重合体、その水素添加 物、またはノルボルネン骨格を有するモノマーと他のオ レフィン系モノマー類との付加重合物である請求項1記 10 載のレジスト組成物。

【請求項3】 レジスト組成物中の光感応性酸発生物質 (B) が3<u>重量</u>部であるとき、厚さ7,000オングス トロームとなるように基板に塗布したレジスト膜の波長 193 nmにおける光線透過率が40%以上となる請求 項1または2記載のレジスト組成物。

請求項1から3のいずれかに記載のレジ 【請求項4】 スト組成物を基板上に塗布する工程と、波長190~2 50 n mの波長光源を用いて露光する工程を含むことを 特徴とするパターン形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ICやLSI等の製造 に用いるレジスト組成物及びその利用に関し、更に詳し くはArFエキシマレーザーなどの遠紫外線、X先、電 子線などの荷電粒子線といった放射線を用いる半導体素 子の超微細加工に有用なレジストとして好適なレジスト 組成物及びその利用に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体素子を製造する場合、シリコンウ 30 エハ表面にレジストを塗布して感光膜を作り、光を照射 して潜像を形成し、ついでそれを現像してネガまたはポ ジの画像を形成するリソグラフィー技術によって画像を 得ている。ところで、IC、LSI、更にVLSIへと 半導体の高集積化、高密度化、小型化、高速化が進むに つれ素子の微細加工に対する要求は高まり、現在では O. 5 μ m以下の微細パターンを形成する技術が要求さ れている。しかしながら、近紫外線や可視光線を用いる 従来のリソグラフィーではこのような微細パターンの形 成がきわめて困難であり、歩留りの低下も著しい。この 40 とを必須成分とするレジスト組成物であって、樹脂 ため、波長350~450 n mの近紫外線光を利用する 従来のフォトリソグラフィーに代えて、露光の解像度を 髙めるために、波長の短い遠紫外線(短波長紫外線)、 波長248nmのKrFエキシマレーザ、波長193n mのArFエキシマレーザなどを用いるリソグラフィー 技術が研究されている。

【〇〇〇3】近紫外線光を利用するリソグラフィーに は、基材高分子としてノボラック樹脂が使用されている が、この樹脂は波長350~450nmの紫外線光に対 する透過性は良好なものの、それより短波長の遠紫外線 50

やKrFまたはArFエキシマレーザのような波長の短 い光に対しては透過率が極端に悪化するため、基体高分 子としてノボラック樹脂を使用した場合には、十分な感 度が得られない、パターン形状が悪いといった問題点が 知られている。

【0004】KrFエキシマレーザ露光用化学増幅型レ ジストの基体樹脂として、ポリビニルフェノール誘導体 を用いることは周知の技術であり、より透過率を向上さ せることを目的とした水素添加ポリビニルフェノール誘 導体を基体高分子として用いる方法(特開平5-249 673号公報など) などが知られている。またArFエ キシマレーザ露光など、更に波長の短い光を用いるリソ グラフィーでは、短波長を吸収する芳香環が樹脂中に存 在することは好ましくない。このため芳香環を持たない メタクリル酸エステル系共重合樹脂を用いることが検討 されている(特開平7-199467号公報)。しかし ながら、ArFエキシマレーザを用いるリソグラフィー についての研究は、まだ実用レベルに到達しておらず、 レジスト特性のバランスの優れたものを得るために、新 20 たなレジストの出現が望まれている段階である。

【0005】ところで透明性の高い樹脂としては、成形 材料に用いられるアモルファスの多環式ポリオレフィン 系樹脂が知られている(特開平1-168725号公) 報、特開平1-311120号公報、特開平1-190 726号公報、特開平3-14882号公報、特開平3 -122137号公報、特開平4-63807号公 報)。しかしながら、これらの樹脂をレジスト用の基体 樹脂として用いることは知られていなかった。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】かかる従来技術のもと で、発明者らは、新たな担波長露光可能なレジスト組成 物を得るべく鋭意研究した結果、多環式のポリオレフィ ン樹脂に酸不安定性構造を担持させた樹脂を用いると、 短波長、特に250mm以下の波長でも高い透明性を保 持することを見い出し、本発明を完成するに到った。 [0007]

【課題を解決するための手段】かくして本発明によれ ば、酸不安定性構造が基体樹脂に担持されている少なく とも1種類の樹脂(A)と、光感応性酸発生物質(B) (A) の基体樹脂が多環式ポリオレフィン樹脂であるこ とを特徴とするレジスト組成物が提供される。

【0008】以下、本発明について詳述する。本発明で 用いられる樹脂(A)は、少なくとも1種類の酸不安定 性構造が、基体樹脂である多環式ポリオレフィン樹脂に 繰り返し担持されている樹脂である。本発明において酸 不安定性構造とは、化学増幅レジストの分野で知られて いる酸不安定性基、酸レイビル基、酸分解性基などと表 現されている基を有する構造であり、酸により分解さ れ、基体樹脂のアルカリ可溶性を増加させる基を含む構 造である。具体的には、特公平2-27660号公報記 載のtーブチルエステル基、t-ブチルカルボナート、 特公平5-69420号公報に記載された3級アルキル オキシ基、t-アミルオキシ基、t-アミルオキシカル ボニル基など3級アルキルオキシ基、3級アルキルオキ シカルボニル基、3級アルキルオキシカルボニルオキシ 基;特公平5-43451号公報記載のアセタール構 造;特開平2-1641436号公報記載のケタール構 造;特願平6-261054号明細書記載の1-アルキ ルシクロアルキルオキシ基、1-アルキルシクロアルキ 10 ルオキシカルボニル基;特願7-284583号明細書 記載の2以上の置換基を有する置換アリルオキシ基、置 換アリルオキシカルボニル基、置換アリルオキシカルボ ニルオキシ基;などが例示される。これらの基は、基体 樹脂に直接結合していても、2価以上の有機基を介して

結合していても良い。

【〇〇〇9】このような酸不安定性構造の中でも特に、 t ーブチル基を含有する構造(t ーブチルオキシカルボ ニル基、 t ーブチルオキシ基、 t ーブチルオキシカルボ ニルオキシ基およびこれらが基体樹脂と2価の有機基を 20 介して結合しているもの)、 t - アミル基を含有する構 造 (tーアミルオキシ基、t-アミルオキシカルボニル 基およびこれらが基体樹脂と2価の有機基を介して結合 しているもの)、1-アルキルシクロアルキルオキシ基 を含有する構造(1-アルキルシクロアルキルオキシ 基、1-アルキルシクロアルキルオキシカルボニル基お よびこれらが基体樹脂と2価の有機基を介して結合して いるもの)、2以上の置換基を有する置換アリルオキシ 基を含有する構造(2以上の置換基を有する置換アリル オキシ基、置換アリルオキシカルボニル基、置換アリル 30 オキシカルボニルオキシ基およびこれらが基体樹脂と2 価の有機基を介して結合しているもの)などが好ましい 例である。

【0010】本発明において基体樹脂となる多環式ポリ オレフィン樹脂とは、特開平1-168725号公報、 特開平1-311120号公報、特開平1-19072 6号公報、特開平3-14882号公報、特開平3-1 22137号公報、特開平4-63807号公報などで 公知の樹脂であり、具体的にはノルボルネン骨格を有す るモノマー (以下、ノルボルネン型モノマーという)の 40 開環重合体、その水素添加物、またはノルボルネン型モ ノマーと他のオレフィン系モノマー類との付加重合物な どであり、好ましくはノルボルネン型モノマーの開環重 合体の水素添加物である。また、ノルボルネン型モノマ - の開環重合体の水素添加物の水素添加の割合は、好ま しくは80%以上、より好ましくは90%以上である。 ノルボルネン型モノマーとオレフィン系モノマー類との 付加重合物の場合、他のオレフィン系モノマー類の使用 量は、ノルボルネン型モノマーに対して50モル%以 下、好ましくは30モル%以下、より好ましくは20モ 50 ネン、5-オクタデシルー2-ノルボルネン等;ジシク

ル%以下である。

【0011】本発明で用いる樹脂(A)の重量平均分子 量は、GPC(ゲル・パーミエーション・クロマトグラ フィ) 法で測定したポリスチレン換算値で、下限が通常 5,000、好ましくは10,000であり、上限は通 常100、000、好ましくは20、000である。こ の下限の範囲未満であると脆く、逆にこの上限を超える と解像性が低下することがある。

【0012】また、樹脂(A)中の酸不安定性構造の担 持の割合は、基体樹脂中の全繰り返し構造単位を100 としたとき、これらのうち酸不安定性構造が担持してい る構造単位が10~100、好ましくは20~80、よ り好ましくは30~70であり、酸不安定性構造の割合 が少ないと感度や解像性の低下がおこり、酸不安定性構 造の割合が多すぎるとパターンが細ることがある。

【0013】上述してきた樹脂(A)の原料となるモノ マーとしては、(1)ノルボルネン型モノマー、(2) 付加重合可能な他のオレフィン系モノマーが挙げられ、 これらを目的に応じて適宜混合して用いることができ る。酸不安定性構造を有さないモノマーのみを原料とし た場合や、酸不安定性構造を有するモノマーの使用量が 少ない場合は、酸不安定性構造を後から導入する変性反 応により、上述の範囲の割合で樹脂に酸不安定性構造を 担持させることができ、原料となるモノマーに予め酸不 安定性構造を導入したものを十分量用いる場合は、必要 に応じて他のモノマー成分と常法により反応させる。

【0014】酸不安定性構造を有するノルボルネン型モ ノマー (1) の具体例としては、上記公報や特開平2-227424号公報、特開平2-276842号公報な どで公知の単量体であって、例えば、ノルボルネン、ジ シクロペンタジエン、ジメタノオクタヒドロナフタレ ン、ジメタノシクロペンタジエノナフタレン、シクロペ ンタジエンの3~4 量体、シクロペンタジエンとテトラ ヒドロインデンとの付加物;これらのノルボルネン型モ ノマーのアルキル、アルキリデン、芳香族置換誘導体; 置換又は非置換のノルボルネン型モノマーにハロゲン、 水酸基、エステル基、アルコキシ基、シアノ基、アミド 基、イミド基、シリル基等の極性基が付加したモノマー 等が挙げられる。

【0015】このようなモノマーとして、より具体的に は、例えば、2-ノルボルネン、5-メチル-2-ノル ボルネン、5,5-ジメチル-2-ノルボルネン、5-エチルー2-ノルボルネン、5-ブチルー2-ノルボル ネン、5-エチリデン-2-ノルボルネン、5-メトキ シカルボニルー2ーノルボルネン、5ーシアノー2ーノ ルボルネン、5-メチル-5-メトキシカルボニル-2 ーノルボルネン、5-フェニル-2-ノルボルネン、5 ーフェニルー5ーメチルー2ーノルボルネン、5ーヘキ シルー2ーノルボルネン、5ーオクチルー2ーノルボル ロペンタジエン、2,3-ジヒドロジシクロペンタジエ ン当;ノルボルネンに一つ以上のシクロペンタジエンが 付加した単量体、その上記と同様の誘導体や置換体、例 えば、1,4:5,8-ジメタノー2,3-シクロペン タジエノー1-1, 2, 3, 4, 4 a, 5, 8, 8 a-オクタヒドロナフタレン、6-メチル-1,4:5,8 ージメタノー1, 4, 4 a, 5, 6, 7, 8, 8 a ーオ クタヒドロナフタレン、1,4:5,10:6,9ート リメタノー2、3-シクロペンタジエノー1,2,3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 9, 9a, 10, 10a-1 10 デカヒドロアントラセン等;シクロペンタジエンがディ ールス・アルダー反応によって多量化した多環構造の単 **量体、その上記と同様の誘導体や置換体、例えば、ジシ** クロペタジエン、2,3-ジヒドロジシクロペンタジエ ン等:シクロペンタジエンとテトラヒドロインデンなど との付加物、その上記と同様の誘導体や置換体、例え ば、1、4-メタノー1、4、4 a、4 b、5、8、8 a, 9 a ー オクタビドロフルオレン、5, 8 ー メタノー 2, 3-シクロペンタジエノ-1, 2, 3, 4, 4 a, 5, 8, 8 a - オクタヒドロナフタレン等; などが挙げ られる。これらのなかでも6-メチル-1,4:5,8 ージメタノー1, 4, 4 a, 5, 6, 7, 8, 8 a ーオ クタヒドロナフタレン (MTD) などのジメタノオクタ ヒドロナフタレン類、ジシクロペンタジエン(DC P)、5-エチリデン-2-ノルボルネン(ENB)及 びこれらの2種類の混合物が好ましい。

【0016】付加重合可能な他のオレフィン系モノマー (2) の具体例としては、エチレン、プロピレン、1-ブテン、3ーメチルー1ーブテン、1ーペンテン、3ー メチルー1ーペンテン、4ーメチルー1ーペンテン、1 ーヘキセン、1-オクテン等のα-オレフィン類;シク ロペンテン、シクロヘキセン、3,4-ジメチルシクロ ペンテン、3-メチルシクロヘキセン、2-(2-メチ ルブチル)-1-シクロヘキセンなどの脂環式オレフィ ν ; 3 a, 5, 6, $7a - \vec{r} + \vec{r} - 4$, $7 - \vec{r} + 3$ ノー1 H-インデン等の非ノルボルネン型式案式オレフ ィン; 1, 4-ヘキサジエン、1,6-オクタジエン、 2-メチル-1, 5-ヘキサジエン、6-メチル-1, 5-ヘプタジエン、7-メチル-1,6-オクタジエ ン、シクロヘキサジエン、ジシクロペンタジエン、メチ ルテトラヒドロインデン、1,5-ヘキサジエン、ノル ボルナジエンなどの非共役ジエン;2ープロペニルー 2, 5-ノルボルナジエン、1, 3, 5-オクタトリエ ン、1、4、9ーデカトリエンなどのトリエン類など、 芳香族性のオレフィン系モノマーが例示される。

【0017】 これらの各モノマーに、常法によって酸不 Aのビス(2,3-ジクロロプロピル) エーテル、ビス 安定性構造を導入し、酸不安定性構造を導入したモノマ フェノールAのビス(2,3-ジブロモプロピル) エーを用い、特開平1-168725号公報、特開平1- ラル、テトラクロロビスフェノールAのビス(2,3-ジブロモプロピル) エーテル、テトラブロモビスフェン 特開平3-14882号公報、特開平3-122137 50 ールAのビス(2,3-ジブロモプロピル) エーテル、

ß

号公報、特開平4-63807号公報に記載された方法で樹脂を合成すれば、本発明で用いる樹脂(A)が得られる。酸不安定性構造を導入したモノマーは、例えば2ーカルボニルオキシメチルプロペンを、常法に従って、エステル交換反応、酸ハライド化したのちアルコールと反応、または脱水縮合剤を用いてカルボキシル基をエステル化する反応によって、酸不安定性基(オキシカルボニル型)を導入することで得られ、更にこれをシクロペンタジエン等のノルボルネン型モノマーと反応させて多環化合物を合成すれば、酸不安定性構造が導入されたノルボルネン型モノマーが得られる。

【0018】本発明において用いられる光感応性酸発生物質(B)(以下、PAGという)は、活性化放射線に露光されるとブレンステッド酸またはルイス酸を発生する物質であれば特に制限はなく、オニウム塩、ハロゲン化有機化合物、キノンジアジド化合物、 α , α 'ービス(スルホニル)ジアゾメタン系化合物、 α -カルボニルー α 'ースルホニルジアゾメタン系化合物、スルホン化合物、有機酸エステル化合物、有機酸アミド化合物、有機酸イミド化合物など公知のものを用いることができる。オニウム塩としては、ジアゾニウム塩、アンモニウム塩、ジフェニルヨードニウムトリフレートなどのヨードニウム塩、トリフェニルスルホニウムトリフレートなどのスルホニウム塩、ホスホニウム塩、アルソニウム塩、オキソニウム塩などが挙げられる。

【0019】ハロゲン化有機化合物としては、ハロゲン 含有オキサジアゾール系化合物、ハロゲン含有トリアジ ン系化合物、ハロゲン含有アセトフェノン系化合物、ハ ロゲン含有ベンゾフェノン系化合物、ハロゲン含有スル ホキサイド系化合物、ハロゲン含有スルホン系化合物、 ハロゲン含有チアゾール系化合物、ハロゲン含有オキサ ゾール系化合物、ハロゲン含有トリアゾール化合物、ハ ロゲン含有2-ピロン系化合物、その他ハロゲン含有へ テロ環状化合物、ハロゲン含有脂肪族炭化水素化合物、 ハロゲン含有芳香族炭化水素化合物、スルフェニルハラ イド化合物などが挙げられ、具体的には、トリス(2, 3 - ジブロモプロピル) ホスフェート、トリス(2,3 ージブロモー3-クロロプロピル)ホスフェート、テト ラブロモクロロブタン、ヘキサクロロベンゼン、ヘキサ ブロモベンゼン、ヘキサブロモシクロドデカン、ヘキサ ブロモビフェニル、アリルトリブロモフェニルエーテ ル、テトラクロロビスフェノールA、テトラブロモビス フェノールA、テトラクロロビスフェノールAのビス (クロロエチル) エーテル、テトラブロモビスフェノー ルAのビス(ブロモエチル)エーテル、ビスフェノール Aのビス(2,3-ジクロロプロピル)エーテル、ビス フェノールAのビス(2,3-ジブロモプロピル)エー テル、テトラクロロビスフェノールAのビス(2,3-ジクロロプロピル) エーテル、テトラブロモビスフェノ

テトラクロロビスフェノールS、テトラブロモビスフェ ノールS、テトラクロロビスフェノールSのビス(クロ ロエチル) エーテル、テトラブロモビスフェノールSの ビス (ブロモエチル) エーテル、ビスフェノールSのビ ス(2,3-ジクロロプロピル)エーテル、ビスフェノ ールSのビス(2,3-ジブロモプロピル)エーテル、 トリス(2,3-ジブロモプロピル)イソシアヌレー ト、2, 2-ビス(4-ヒドロキシ-3, 5-ジブロモ フェニル) プロパン、 2, 2 ービス(4 ー(2 ーヒドロ キシエトキシ) -3, 5-ジブロモフェニル) プロパン 10 などのハロゲン系難燃剤やジクロロジフェニルトリクロ ロエタン、ペンタクロロフェノール、2,4,6ートリ クロロフェニル 4-ニトロフェニルエーテル、2,4 ージクロロフェニル 3'ーメトキシー4'ーニトロフ ェニルエーテル、2,4-ジクロロフェノキシ酢酸、 4, 5, 6, 7ーテトラクロロフタリド、1, 1ービス (4-クロロフェニル) エタノール、1,1-ビス(4 ークロロフェニル) -2, 2, 2-トリクロロエタノー ル、2,4,4',5-テトラクロロジフェニルスルフ ィド、2,4,4',5-テトラクロロジフェニルスル 20 ホンなどの有機クロロ系農薬などが例示される。

【0020】キノンジアジド化合物の具体例としては、
1,2ーベンゾキノンジアジドー4ースルホン酸エステル、1,2ーナフトキノンジアジドー4ースルホン酸エステル、1,2ーナフトキノンジアジドー5ースルホン酸エステル、2,1ーナフトキノンジアジドー4ースルホン酸エステル、2,1ーベンゾキノンジアジドー5ースルホン酸エステルのようなキノンジアジド誘導体のスルホン酸エステルや1,2ーベンゾキノンー2ージアジドー4ースルホン酸クロライド、1,2ーナフトキノンー2ージアジドー5ースルホン酸クロライド、1,2ーナフトキノンー1ージアジドー6ースルホン酸クロライド、1,2ーナフトキノンー1ージアジドー6ースルホン酸クロライド、1,2ーボンゾキノンー1ージアジドー5ースルホン酸クロライドなどが挙げられる。

【0021】 α、αービス(スルホニル)ジアゾメタン 系化合物としては、未置換、対称的にまたは非対称的に 置換されたアルキル基、アルケニル基、アラルキル基、芳香族基、またはヘテロ環状基を有するα、αービス 40 (スルホニル)ジアゾメタンなどが挙げられる。αーカルボニルーαースルホニルジアゾメタン系化合物の具体 例としては、未置換、対称的にまたは非対称的に置換されたアルキル基、アルケニル基、アラルキル基、芳香族基、またはヘテロ環状基を有するαーカルボニルーαースルホニルジアゾメタンなどが挙げられる。スルホン化合物の具体例としては、未置換、対称的にまたは非対称的に置換されたアルキル基、アルケニル基、アラルキル 表、芳香族基、またはヘテロ環状基を有するスルホン化合物、ジスルホン化合物などが挙げられる。有機酸エス 50

テルとしては、カルボン酸エステル、スルホン酸エステル、リン酸エステルなどが挙げられ、有機酸アミドとしては、カルボン酸アミド、スルホン酸アミド、リン酸アミドなどが挙げられ、有機酸イミドとしては、カルボン酸イミド、スルホン酸イミド、リン酸イミドなどが挙げられる。

【0022】上述したようなPAGは、KrFエキシマ レーザ用レジストにも用いられるものであるが、なかで も、芳香環を有さず、ArFエキシマレーザの波長付近 (185.5~220nm) の光吸収が少ないもの、例 えば特開平7-199467号公報の第9~10欄に一 般式(II)又は(III)で記載されたような化合物 やその具体例、即ち、シクロヘキシルメチル(2ーオキ ソシクロヘキシル) スルホニウムトリフルオロメタンス ルホナート、ジシクロヘキシル(2-オキソシクロヘキ シル) スルホニウムトリフルオロメタンスルホナート、 ジシクロヘキシルスルホニルシクロヘキサノン、ジメチ ル(2-オキソシクロヘキシル)スルホニルトリフルオ ロメタンスルホナート、トリフェニルスルホニウムトリ フルオロメタンスルホナート、ジフェニルヨードニウム トリフルオロメタンスルホナート、N-ヒドロキシスク シイミドトリフルオロメタンスルホナート等が挙げられ

【0023】これらのPAGは、単独で使用しても2種類以上を混合して用いてもよい。これらのPAGの配合量は、本発明で用いる樹脂100重量部に対して下限は通常0.01重量部、好ましくは0.2重量部であり、上限は通常50重量部、好ましくは30重量部である。0.01重量部未満ではバターンの形成が不可能となり。50重量部を超えると現像残が発生し易くなったり、パターン形状が悪化するなどの問題が生じ、いずれの場合もレジストの性能上好ましくない。

【0024】本発明に於て、前記樹脂とPAGとからな るレジスト組成物は、溶剤に溶解させて用いる。溶剤 は、一般にレジスト組成物用の溶剤として使用されてい るものを用いることができ、具体例としては、アセト ン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、シクロペ ンタノン、シクロペンタノン、シクロヘキサノンなどの ケトン類;nープロパノール、iープロパノール、nー ブタノール、iーブタノール、tーブタノール、シクロ ヘキサノールなどのアルコール類; エチレングリコール ジメチルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテ ル、ジオキサンなどのエーテル類;エチレングリコール ジメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエー テル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロ ピレングリコールモノエチルエーテルなどのアルコール エーテル類;ギ酸プロピル、ギ酸ブチル、酢酸プロピ ル、酢酸ブチル、プロピオン酸メチル、プロピオン酸エ チル、酪酸メチル、酪酸エチルなどのエステル類;2-オキシプロピオン酸メチル、2-オキシプロピオン酸エ

チル、2-メトキシプロピオン酸メチル、2-メトキシ プロピオン酸エチルなどのオキシカルボン酸エステル 類;セロソルブアセテート、メチルセロソルブアセテー ト、エチルセロソルブアセテート、プロピルセロソルブ アセテート、ブチルセロソルブアセテートなどのセロソ ルブエステル類;プロピレングリコール、プロピレング リコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレング リコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレング リコールモノブチルエーテルなどのプロピレングリコー ル類: ジエチレンギリコールモノメチルエーテル、ジエ 10 チレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリ コールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチ ルエーテルなどのジエチレングリコール類;トリクロロ エチレンなどのハロゲン化炭化水素類;トルエン、キシ レンなどの芳香族炭化水素類:N.Nージメチルホルム アミド、N, Nージメチルアセトアミド、Nーメチルア セトアミド、N-メチルピロリドンなどの極性溶媒など が例示され、これらは単独または2種類以上を混合して 用いてもよい。

【0025】本発明においては、添加剤としてレジスト 組成物に一般に添加されているもの、例えばレジスト組 成物に一般に添加されるシリコン系又はフッ素系の界面 活性剤、保存安定剤、増感剤、ストリエーション防止剤 など相溶性のある添加剤を含有させることができる。

【0026】本発明の組成物において、前記樹脂(A) は、放射線の照射により酸発生剤から制止する酸の作用 を受けて、被照射部分の溶解度が変化する。本発明の組 成物は、アルカリ現像液を用いることにより、ポジ型レ ジストとして作用する。基体樹脂として多環式ポリオレ フィン樹脂を用いることにより、耐ドライエッチング 性、解像性、溶解抑止効果などのレジスト特性が向上す る。

【0027】また、本発明のレジスト組成物のうち、特 に光感応性酸発生物質(PAG)の量が3重量部である 本発明のレジスト組成物を、膜厚7,000オングスト ロームに塗布したレジスト膜に波長193nmの光を照 射したとき、光線透過率が20%以上、好ましくは30 %以上、より好ましくは40%以上であるものが実用的 である。尚、ここで測定される光線透過率は、厚さ1 m mの石英板にレジストを膜厚7,000オングストロー ムに塗布し、193nmの遠紫外線を照射することによ り測定される光線透過率(%)である。

【0028】本発明のレジスト組成物は現像液として通 常、アルカリ水溶液を用いるが、具体例としては、水酸 化ナトリウム、水酸化カリウム、ケイ酸ナトリウム、ア ンモニアなどの無機アルカリの水溶液;エチルアミン、 プロピルアミンなどの第一アミン類の水溶液; ジエチル アミン、ジプロピルアミンなどの第二アミンの水溶液; トリメチルアミン、トリエチルアミンなどの第三アミン の水溶液;ジエチルエタノールアミン、トリエタノール 50 解させ、次いでエーテルで抽出した。抽出後のエーテル

アミンなどのアルコールアミン類の水溶液; テトラメチ ルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウ ムヒドロキシド、トリメチルヒドロキシメチルアンモニ ウムヒドロキシド、トリエチルヒドロキシメチルアンモ ニウムヒドロキシド、トリメチルヒドロキシエチルアン モニウムヒドロキシドなどの第四級アンモニウムヒドロ キシドの水溶液などが挙げられる。また、必要に応じ て、上記アルカリ水溶液にメタノール、エタノール、プ ロパノール、エチレングリコールなどの水溶性有機溶 媒、界面活性剤、樹脂の溶解抑止剤などを添加すること ができる。

10

【0029】本発明のパターン形成方法は、上述してき た本発明のレジスト組成物を基板上に回転塗布などの方 法で塗布し、任意の膜厚(通常、乾燥膜厚で0.01μ m~1 μ m程度) の膜を形成させ、これに波長190~ 250nmの波長光源を用いて露光するものである。ま た、膜を形成した後、露光前にレジストが熱により劣化 しない範囲の温度、通常90~190℃、好ましくは1 20~170℃でベークするのがよい。温度がこの範囲 を超えて低温であると表面難溶解層が発生し、逆に高温 であると熱硬化や熱分解が起こる恐れがあるので好まし くない。露光光源として、マスクを介して露光できるA r Fエキシマレーザ光を用いるとき、とりわけ本発明の 効果が発揮される。更に露光後のベークを行うのが普通 であるが、この露光後ベークは通常の温度、即ち70~ 180℃である。現像は上述した現像液を用いればよ

[0030]

【発明の効果】かくして本発明によれば、感度や解像度 などレジスト諸特性に優れたレジスト組成物が得られ、 更に本発明のレジスト組成物は遠紫外線光やArFエキ シマレーザー光のような短波長光や電子線を充分に透過 するので、微細加工された半導体素子を得ることができ る。

[0031]

【実施例】以下に実施例を挙げて本発明をさらに具体的 に説明する。なお、各例中の部及び%は、特に断りのな い限り重量基準である。なお、光線透過率は、光感応性 酸発生物質 (PAG) の量を3重量部に調製したレジス ト組成物を、膜厚7,000オングストロームに塗布し たレジスト膜に波長193nmの光を照射したときの透 過率(%)を測定した値である。

【0032】(合成例)水素添加ポリ 8-メチル-8 -t-ブトキシカルボニルテトラシクロ [4, 4, 0, $1^{2,5}$, $1^{7,10}$] -3 -F+E++

tーブチルアルコール1mol、乾燥ジメチルアニリン 1 m o 1 を乾燥エーテル200 m 1 に溶解させ、氷冷攪 拌下、メタクリル酸クロライド1mo1を滴下した。滴 下完了から更に2時間撹拌した後、水を加えて固体を溶

層は10%硫酸水溶液で洗浄後、乾燥した。溶媒を減圧 留去し、残渣を蒸留し、tーブチルメタクリレートを精 製した。このようにして得られたt-ブチルメタクリレ ートO. 15molと、ジシクロペンタジエンO. 15 molとを混合し、-20℃で2時間撹拌し、5-ブト キシカルボニルー5ーメトキシー2ーノルボルネンを得 た (収率96%)。 更に、得られた5-メトキシ-5tーブトキシカルボニルー2ーノルボルネン0.1mo 1とジシクロペンタジエン0.05mo1とを混合し、 重合禁止剤としてハイドロキノンWPO. 005mol 10^{-2} 条件で、110C3時間反応させ、水素添加した。得 加え、200℃で3時間反応させて、8-メチル-8t-ブトキシカルボニルテトラシクロ[4,4,0,1 2,5, 17,107 - 3 - ドデセンを得た。

【0033】重合容器内で、上述の方法により得られた 8-メチル-8-t-ブトキシカルボニルテトラシクロ $[4, 4, 0, 12,5, 17,10] - 3 - \tilde{F} = 100$ mo1をトルエンに、モノマー濃度10重量%となるよ うに溶解させ、ここに分子量調節剤として1-ヘキセン 0.70mol、ジエチルアルミニウムクロライド0. 25mol、六塩化タングステン0.15molの順に 加え、70℃で1時間反応させた。反応後、イソプロピ ルアルコールで凝固・乾燥させて、ポリ 8-メチルー 8-t-ブトキシカルボニルテトラシクロ [4, 4, 0, 12,5, 17,10] -3-ドデセンを得た。続いて得 られたポリマー溶液の半量に、トリエタノールアミンの 20重量%水溶液を加え、撹拌した後、水層を分離し、 有機層を耐圧反応容器内に移し、触媒としてパラジウム ーカーボン(活性炭担持バラジウム:Pd濃度5%)1 0重量部を加え、水素ガス圧10Kg/cm²条件で、 150℃4時間反応させ、水素添加した。得られた反応 30 度は表1に示す通りであった。 液は、冷却後、反応系より触媒を濾別し、濾液にメタノ ールを添加してポリマーを凝固・乾燥させた。 得られた

12 水素添加ポリ 8-メチル-8-t-ブトキシカルボニ ルテトラシクロ [4, 4, 0, 1^{2,5}, 1^{7,10}] -3-

ドデセンの水素添加率は、1H-NMRスペクトルから 約95%であった。

【0034】残るポリマー溶液の半量に、トリエタノー ルアミンの20重量%水溶液を加え、攪拌した後、水層 を分離し、有機層を耐圧反応容器内に移し、触媒として パラジウムーカーボン (活性炭担持パラジウム: Р d 濃 度5%) 10重量部を加え、水素ガス圧10Kg/cm られた反応液は、冷却後、反応系より触媒を濾別し、濾 液にメタノールを添加してポリマーを凝固・乾燥させ た。得られた水素添加ポリ 8-メチル-8-t-ブト キシカルボニルテトラシクロ $[4, 4, 0, 1^{2,5}, 1]$ 7,10] -3-ドデセンの水素添加率は、¹H-NMRス ペクトルから約80%であった。

【0035】(実施例1~5、比較例1~3)樹脂濃度 が14重量%となるように、表1記載の処方で樹脂およ び光感応性酸発生物質をシクロヘキサノンに溶解させた 20 後、0.2 μmのポリテトラフルオロエチレン製フィル ター (ミリポア社製) で濾過してレジスト溶液を調製し た。このレジスト溶液をシリコンウエハー上にスピンコ ートした後、120℃で60秒間のベークを行うことに より膜厚7,000オングストロームのレジスト膜を形 成した。このウエハーをArFエキシマステッパー(N A=0.55) とテスト用レクチルを用いて露光を行っ た。続いて、各ウエハについてテトラメチルアンモニウ ムヒドロキシド水溶液で1分間の浸漬現象を行い、ポジ 型パターンを得た。得られたレジスト膜の透過率と解像

[0036]

【表1】

(表 1)

	を は は は は は は は は は は は は は は は は は は は		世免生前		透過率	解象度
	水添率	重量部	梅 無	重量部	(%)	(μm/s)
実施例 1	95%	100	PAGI	3	61.9	0.18
実施例2	95%	100	PAG3	3	70.0	0.18
実施例3	80%	100	PAGI	3	47. 1	0. 22
実施例4	未水紙	100	PAGI	3	33.3	0.30
実施例 5	95%	100	PAG2	3	20. 5	0.28
比較例 1		100	PAG1	3	13. 0	0. 50
比較例2		100	PAG1	3	5. 2	1. 0
比較較3		100	PAG1	3	5. 1	1. 0.

【0037】 [樹脂の欄]

- ・実施例の樹脂は。合成例にて得られた樹脂である。
- ・比較例1の樹脂は、4-ヒドロキシビニルフェノールとt-ブチルメタクリレートとの57:43(仕込みモル比)の共重合体である。
- ・比較例2の樹脂は、4-ヒドロキシビニルフェノールと3-メチル-2-ブテニル メタクリレートとの54:46(仕込みモル比)の共重合体である。
- *・比較例3の樹脂は、4ーヒドロキシビニルフェノールと4ー(tーブチルオキシカルボニルメチル)ビニルフェノールとの50:50(仕込みモル比)の共重合体である。
- 30 [酸発生剤の欄]

PAG1=トリフェニルスルホネート トリフレート PAG2=次式(1)

【化1】"

$$\begin{array}{c|c}
 & O \\
 & | \\
 & N-O-S-CF_3 \\
 & O
\end{array}$$
(1)

PAG3=次式(2)

※ ※ 【化2】

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 \\
S^+
\end{array}$$

$$CF_3SO_3^-$$

【0038】この結果から、透過率が低いとArFエキとが判る。 シマレーザ露光ではパターンが十分得られないというこ